



## AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI MECFORPACK

Bologna, 12 – 13 novembre 2009

**MECFORPACK**, la Mostra Convegno dedicata alla Meccanica di precisione, ai materiali innovativi, all'Engineering & Tecnologie, all'Elettronica, alla Componentistica per la progettazione e produzione di Macchine Automatiche e Sistemi di Confezionamento – organizzata da BolognaFiere – inaugura, a Bologna, il 12 novembre 2009.

Nella sua sede ideale, al centro della "packaging valley" italiana – caratterizzata da un distretto industriale di prestigio su scala internazionale - **MECFORPACK**, propone, anche nella seconda edizione, un articolato programma di convegni, focalizzati alle tematiche di maggior attualità per il settore che la trasformano nell'ideale piattaforma di formazione e informazione per gli operatori del settore.

Fra le novità di questa edizione, la nuova data di svolgimento, passata dall'inizio di giugno alla più funzionale collocazione temporale nel mese di novembre, ben inserita nel calendario internazionale delle manifestazioni fieristiche b2b.

Altra novità di rilievo, la presenza nel **Comitato tecnico-scientifico** dell'evento, dei rappresentanti di alcuni fra i più importanti produttori di macchine automatiche, impianti e sistemi per il confezionamento. Ricordiamo GD, Ima Group, Marchesini Group, Marzorati TI, Sacmi, Tetra Pak,... che partecipano anche alla manifestazione in veste di espositori, confermando l'importanza di MECFORPACK quale momento di incontro e confronto per il settore.

Il programma convegnistico, già apprezzato nella prima edizione dell'evento per specializzazione e contenuti propone, anche nel 2009, approfondimenti di forte attualità (evoluzione tecnologica nello sviluppo e nella produzione di componenti in lega leggera; controllo delle vibrazioni e del rumore nelle macchine automatiche; innovazioni nell'elettronica; progettazione integrata meccanica elettronica/software; processi di trasformazione secondaria delle leghe metalliche; direct drive e motori lineari; robot paralleli per il packaging; trattamenti superficiali; tecnologie innovative di simulazione nella progettazione; soluzioni di prototipazione/produzione rapida e reverse engineering per il packaging,...).

Di forte attualità e interesse, fra i convegni in programma gli appuntamenti organizzati rispettivamente da ADACI (Associazione italiana di management degli approvvigionamenti) e Ma Tech.

Il primo, la tavola rotonda **Contrastare la recessione e crisi economica attraverso gli acquisti** - in programma il 12 novembre a partire dalle ore

14.30 – si pone l'obiettivo di individuare alcuni plus finalizzati a una maggiore competitività del sistema impresa; il secondo, **Packaging 2010: Nuovi Materiali, Efficienza Energetica, Ambiente** – in programma il 13 novembre dalle ore 14,30 – è l'occasione per conoscere le ultime novità in termini di materiali e tecnologie di processo applicabili al mondo del packaging, in coerenza con le più recenti evoluzioni del mondo industriale ed economico: biopolimeri strutturali, rinforzi per compositi a base naturale, polimeri espansi derivati dalla soia, rivestimenti strutturali a basso impatto energetico, metalli leggeri da iniezione.

### **I PATROCINI**

Numerose, infine, le associazioni e le realtà che hanno concesso il patrocinio alla manifestazione: ADACI, AIAS, AIM, APII, AM, ANIPLA, APRI, ASSIM, ASSIOT, ASSODESIGN, ASSOMOTORACING, ASSOPROMAG, CNA Produzione, CRIT RESEARCH, FAST, FEDERACCIAI, IIR, IIS, MaTech, NAFEMS ITALIA, OCTIMA, PST GALILEO, SINERGITEC, SIRI, UNINDUSTRIA BOLOGNA.

Bologna, novembre 2009  
(generale 09)